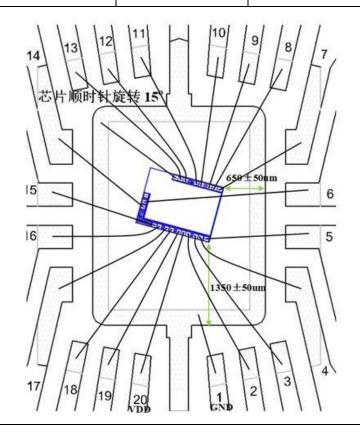


产品工艺确认书

确认书统	扁号	202301117MT-420-DIP20-HS16F3612W-01										
产品型号		HS16F3612W			封装形式	DIP20L			客户代码		KH0420	
芯片 DIE		芯片型号 Die Type		片尺寸)ie Size (um)	焊点尺寸 BPO(um)	焊点最小间距 BPP(um)		Alumin	层厚度 ium Layer ness (um)	焊点下 是否有器件 Circuit Under Pad	减薄 BG	芯片厚度 Die thickness (um)
А		HS5137	1260*950 (含 60um 划片道)		60*60	1	/	0.8		是	是	280±10
可靠性	要求	散热要求		工作电压		工作电流(A)		工作结温 Tj		焊接温度		
												,



特殊说明

197/19073									
BOM 信息							框架示意图		
材料			型						
焊线直径	焊线 1:20um [;]	铜线							
焊丝数量	焊丝 1:21								
框架规格	DIP20L(2P)铜	框架(110*140mil2)	3 3					
	上芯方式	弌	A:粘片胶粘片						
粘片材料	— \#	首选	A:导电胶 S21	10		31			
	二选一	备选				303			
塑封料	二选一	首选	环保料 EMG-	-350					
至 到 科	—远一	备选				PIN	0 0		
拟 制	陈露		研发部审批		工程部审批		公司审批		
日期	2023-01-17		日期	日期			日期		

注:1、产品完成工程试封后,客户端务必进行终端使用环境及电性能测试(如带电老化),考核通过后才能进行量产;

2、客户确认压焊图,无异议请签字回传。

客户回签及特殊要求

客户要求及回签